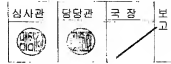


출력 일자 : 2008/10/23

발송번호 : 9-5-2004-014223787

발송일자 : 2004. 04. 12

제출기일 : 2004. 06. 12



## 특허청 의견제출통지서

출원인 명칭 주식회사 파이컴 외 1 명 (출원인코드: 120000063927)  
 주소 서울 금천구 가산동 60-29번지  
 대리인 성명 김인한  
 주소 서울특별시 서초구 서초동 1695-4 대림빌딩502호 월쳐국제특허법률사무소  
 출원번호 10-2003-0016635  
 발명의 명칭 프로브 포지셔닝 및 본딩시스템 및 그 방법

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법시행규칙 별지 제25호의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기를 바랍니다. (상기 제출기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장승인통지는 하지 않습니다.)

### [이유]

1. 이 출원의 특허청구범위 제1항 및 제4항 내지 제6항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적인 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

### [아래]

본원발명은 레이저에 의한 본딩과 핑셋에 의한 프로브 고정장치부가 특징인 프로브 포지셔닝 및 본딩시스템으로 인정되나, 등록실용공보 제0004245호(1989.06.26. 이하 인용발명이라 합니다)에서 반도체 칩 자동본딩 장치 기술이 개시되어 있어 본원발명 제1항의 작업대, 지지대, 마이크로스코프, 고정장치부, 스테이지 및 로딩장치부와 유사하고, 일본공개특허공보 소60-247487호(1985.12.07. 이하 인용발명2라 합니다)에서 레이저에 의한 와이어 본딩장치 기술이 개시되어 있어 본원발명의 레이저와 프로브 고정장치부와 유사하고, 미국특허공보 05811751호(1998.09.22. 이하 인용발명3이라 합니다)에서는 프로브 스테이션과 레이저 절단기술이 개시되어 있어, 본원발명의 마이크로스코프, 레이저, 스테이지부와 유사합니다.

따라서 본원발명의 청구범위 제1항 및 제4항 내지 제6항에 기재된 발명은 인용발명1, 인용발명2 및 인용발명3의 기술들의 결합으로부터 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있습니다.

2. 이 출원은 특허청구범위의 기재가 아래에 지적인 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제5항 및 동법시행령 제5조제5항의 규정에 의한 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

본원발명의 청구범위 제5항은 201상의 항을 인용하는 청구항이나 항의 번호를 책임적으로 기재하지 않아 특허법 제42조제5항 및 동법시행령 제5조제5항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

[첨 부]

첨부1 등록실용공보 0004245호(1989.06.26) 1부.

첨부2 일본공개특허공보 소60-247487호(1985.12.07) 1부.

첨부3 미국특허공보 05811751호(1998.09.22) 1부. 끝.

2004.04.12

특허청

전기전자심사국

반도체심사담당관실

심사관 맹성재



심사관 김준학



<<안내>>

문의사항이 있으시면 ☎ 042)481-5727 로 문의하시기 바랍니다.